



**上海新阳半导体材料股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

二〇一四年十月

## 第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议

三、公司负责人王福祥、主管会计工作负责人邵建民及会计机构负责人(会计主管人员)周红晓声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	998,015,086.75	951,994,824.33	4.83%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	842,102,782.83	795,467,091.50	5.86%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.3282	6.9900	4.84%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	107,583,773.07	221.47%	261,442,894.90	149.72%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	17,503,314.56	261.29%	48,130,206.59	119.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	6,762,899.84	-54.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0589	-54.09%
基本每股收益（元/股）	0.15	150.00%	0.42	61.54%
稀释每股收益（元/股）	0.15	150.00%	0.42	61.54%
加权平均净资产收益率	2.14%	0.87%	5.87%	0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.10%	0.82%	5.75%	-0.60%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-25,776.57	固定资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	671,894.96	45-28nm 配线用超高纯 Cu 阳极材料制备与产业化补助 40.49 万元，其他政府补助 26.70 万元

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	446,479.29	银行理财产品投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	410,986.13	专利补助及其他政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-404,894.96	45-28nm 配线用超高纯 Cu 阳极材料制备与产业化项目对应支出
减：所得税影响额	156,910.61	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	941,778.24	--

## 二、重大风险提示

### 1、新产品开发所面临的风险

公司的电子化学品具有品种多、批量少、升级快、研发投入大、周期长、风险高等特点，需要持续开

发和创新。产品研发试制成功后，进行大规模生产时，任何设备工艺参数缺陷、员工素质差异等都可能导  
致产品品质波动，面临产品难以规模化生产风险。

公司通过多年持续不断的研发投入，加强技术储备和科研管理，掌握了自主知识产权的核心技术，在  
电子化学品研发及生产领域积累了较为丰富的经验和技術储备，能够降低新产品开发的风险。

## 2、新产品市场推广风险

由于芯片制造工艺对环境、材料的严格要求，芯片制造企业一般选择认证合格的安全供应商保持长期  
合作，从而降低材料供应商变化可能导致的产品质量风险；同时，新的材料供应商必须通过芯片制造企业  
严格的公司和产品评估认证才能成为其合格供应商。因此，公司芯片铜互连电镀液及添加剂等新产品大规  
模市场销售市场推广面临客户的认证意愿、对公司质量管理能力的认可以及严格的产品认证等不确定因  
素，存在一定的市场推广风险。

公司一直高度重视新市场推广工作，并通过加大新产品市场开发投入、严格新产品质量管理、引进新  
市场专业人员等手段控制新市场推广的风险。

## 3、投资规模扩张和研发投入导致盈利能力下降的风险

随着募投项目逐步建成投产，公司投资规模迅速扩大，固定资产大幅增加将导致折旧成本大幅上升，  
同时公司近年来研发投入较大，如果公司市场开发工作进展不顺利，营业收入不能实现同步增长，将会导  
致公司盈利能力下降的风险。

公司将全力做好新市场开发，不断挖掘和发现新的客户，力争减少盈利能力下降的风险。同时公司也  
集约运行，从管理上挖掘潜力，把运行成本的上升控制到最小程度。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		3,350				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD	境外法人	21.50%	24,472,000			
上海新晖资产管 理有限公司	境内非国有法人	17.90%	20,368,000			

上海新科投资有限公司	境内非国有法人	12.58%	14,320,000			
李昊	境内自然人	10.75%	12,233,938	12,233,938		
苏州和信达股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.04%	3,460,104	3,460,104		
周海燕	境内自然人	2.69%	3,058,484	3,058,484		
王霞	境内自然人	2.17%	2,471,503	2,471,503	质押	2,471,500
耿雷	境内自然人	1.79%	2,038,990	2,038,990		
胡美珍	境内自然人	1.63%	1,853,627	1,853,627	质押	1,850,000
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.15%	1,307,654			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD	24,472,000	人民币普通股	24,472,000			
上海新晖资产管理有限公司	20,368,000	人民币普通股	20,368,000			
上海新科投资有限公司	14,320,000	人民币普通股	14,320,000			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,307,654	人民币普通股	1,307,654			
全国社保基金四一一组合	1,049,914	人民币普通股	1,049,914			
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	960,001	人民币普通股	960,001			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	917,663	人民币普通股	917,663			
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	800,685	人民币普通股	800,685			
温美华	574,901	人民币普通股	574,901			
海通证券股份有限公司	500,000	人民币普通股	500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>发起人股东 SIN YANG INDUSTRIES &amp; TRADING PTE LTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司为关联公司，属同一控制人控制下的一致行动人。李昊、苏州和信达股权投资合伙企业（有限合伙）、周海燕、王霞、耿雷、胡美珍是本次重大资产重组后持有公司有限售条件流通股 14 名股东的其中 6 名，其中李昊与周海燕为夫妻关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。</p>					

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无
------------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李昊	12,233,938	0	0	12,233,938	协议约定	2016-10-17
周海燕	3,058,484	0	0	3,058,484	协议约定	2016-10-17
耿雷	2,038,990	0	0	2,038,990	协议约定	2016-10-17
孙国平	815,596	0	0	815,596	协议约定	2016-10-17
周明峰	407,798	0	0	407,798	协议约定	2016-10-17
陶月明	407,798	0	0	407,798	协议约定	2016-10-17
王海军	305,848	0	0	305,848	协议约定	2016-10-17
徐辉	305,848	0	0	305,848	协议约定	2016-10-17
程焱	407,798	0	0	407,798	协议约定	2014-10-17
罗瑞娥	407,798	0	0	407,798	协议约定	2014-10-17
胡美珍	1,853,627	0	0	1,853,627	协议约定	2014-10-17
王霞	2,471,503	0	0	2,471,503	协议约定	2014-10-17
苏州和信达股权投资合伙企业 (有限合伙)	3,460,104	0	0	3,460,104	协议约定	2014-10-17
苏州国发黎曼创业投资有限公司	444,870	0	0	444,870	协议约定	2014-10-17
邵建民等 88 名限制性股票激励对象 (第一期解锁)	0	0	556,000	556,000	股权激励	2015-07-04
邵建民等 88 名限制性股票激励对象 (第二期解锁)	0	0	556,000	556,000	股权激励	2016-07-04
合计	28,620,000	0	1,112,000	29,732,000	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因：

注：2013年9月30日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“母公司”）收购了江苏考普乐新材料有限公司（以下简称“江苏考普乐”）100%股权，2013年三季报，母公司合并了江苏考普乐2013年9月30日期末资产负债表，未合并江苏考普乐2013年1-9月份当期损益表。

未合并江苏考普乐报表之前以下简称“合并前”；合并江苏考普乐报表之后以下简称“合并后”。

#### 一、资产负债表项目

1.本报告期末，货币资金比年初减少10065万元，下降46%。主要原因：本报告期母公司投资上海新阳海斯高科技材料有限公司及上海新昇半导体科技有限公司10312万元。

2.本报告期末，预付账款比年初增加350万元，增长148%。主要原因：购入设备预付款。

3.本报告期末，应收利息为0，比年初减少147万元。主要原因：本报告期定存资金减少，计提的应收利息减少所致。

4.本报告期末，存货比年初增加2502万元，增长54%，主要原因：

（1）母公司存货比年初增加632万元，增长35%，主要原因是由于设备订单增加，设备在制品和原材料增加所致；

（2）江苏考普乐存货比年初增加1867万元，增长66%，主要原因是销售旺季生产备货导致原材料增加310万元，产成品增加498万元，发出商品增加1026万元所致。

5.本报告期末，其他流动资产比年初减少68万元，下降100%。主要原因：销售增长，期末未抵扣进项税减少所致。

6.本报告期末，持有至到期投资为0，比年初减少1500万元。主要原因：本报告期银行理财产品到期后未购买所致。

7.本报告期末，长期股权投资比年初增加10000万元，增长15385%。主要原因：本报告期母公司投资上海新昇半导体科技有限公司10000万元所致。

8.本报告期末，固定资产净值比年初增加10164万元，增长197%。主要原因：本报告期母公司固定资产净值比年初增加10212万元，主要是本报告期募投项目完工结转增加固定资产所致；

9.本报告期末，在建工程比年初减少7217万元，下降61%，主要原因：



(1) 母公司在建工程比年初减少8684万元，下降91%，因为本报告期募投项目完工结转，在建工程转入固定资产所致；

(2) 江苏考普乐在建工程比年初增加1467万元，增长64%，因为本报告期考普乐年产12000吨环保型功能性涂料建设项目投资增加所致。

10.本报告期末，预收款项比年初减少390万元，下降61%，主要原因：江苏考普乐期末比期初减少384万元，下降740%，预收账款冲转所致。

11.本报告期末，应付职工薪酬比年初减少221万元，下降71%，主要原因：2013年末计提奖金已发放所致。

## 二、利润表项目

1.营业收入：2014年1-9月营业收入比上年同期增加15675万元，增长150%。主要原因是：

(1) 合并前，2014年1-9月母公司比上年同期增加815万元，增长7.78%；

(2) 合并后，营业收入增加14860万元。

2.营业成本：2014年1-9月营业成本比上年同期增加10255万元，增长202%。主要原因是：

(1) 合并前，2014年1-9月母公司比上年同期增加1654万元，增长33%，主要原因是募投项目运行成本增加、人力资源成本上升、销售产品结构变动所致。

(2) 合并后，营业成本增加8601万元。

3.营业税金及附加：2014年1-9月营业税金及附加比上年同期增加108万元，增长517%。主要原因是：

(1) 合并前，2014年1-9月母公司比上年同期增加19万元，增长90.71%，主要原因是应交增值税增加；

(2) 合并后，营业税金及附加增加89万元。

4.销售费用：2014年1-9月销售费用比上年同期增加1014万元，增长189%。主要原因是：

(1) 合并前，2014年1-9月母公司比上年同期增加54万元，增长10%，

(2) 合并后，销售费用增加960万元。

5.财务费用：2014年1-9月财务费用比上年同期增加279万元，增长53%。主要原因是：

(1) 2014年1-9月母公司比上年同期增加210万元，增长40%，主要原因是本报告期利息收入减少所致；

(2) 合并后，财务费用增加63万元。

6.投资收益：2014年1-9月投资收益比上年同期减少22万元，下降33%。主要原因是：

(1) 2014年1-9月母公司比上年同期减少101万元，下降77%；主要原因是：本报告期减少购买银行理财产品所致；

(2) 合并后，投资收益增加8万元；

(3) 其他子公司合并抵销影响增加71元。

7.营业外收入：2014年1-9月营业外收入比上年同期减少1379万元，下降92%。主要原因是：

(1) 2014年1-9月母公司比上年同期减少1406万元，下降94%。原因是02专项项目结束，本报告期确认政府补助收入减少所致；

(2) 合并后，营业外收入增加27万元。

8.营业外支出：2014年1-9月营业外支出比上年同期减少7万元，下降45%。主要原因是：

(1) 2014年1-9月母公司比上年同期减少8万元，下降56%。原因是本报告期慈善捐赠支出减少所致；

(2) 合并后，营业外支出增加3万元；

(3) 其他子公司合并影响减少2万元。

9.所得税费用：2014年1-9月所得税费用比上年同期增加560万元，增长145%。主要原因是：

(1) 2014年1-9月母公司比上年同期减少130万元，下降34%。原因是本报告期利润总额减少所致；

(2) 合并后，所得税费用增加690万元。

### 三、现金流量表项目

1.销售商品、提供劳务收到的现金：2014年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加10739万元，增长91.12%。主要原因是：

(1) 2014年1-9月母公司比上年同期增加289万元，增长2.45%；

(2) 合并后，销售商品、提供劳务收到的现金增加10446万元。

2.收到的税费返还：2014年1-9月收到的税费返还比上年同期增加3万元，增长203.11%。主要原因是：2014年1-9月母公司比上年同期增加3万元，增长272.04%。

3.收到其他与经营活动有关的现金：2014年1-9月收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加501万元，增长391%。主要原因是：

(1) 2014年1-9月母公司比上年同期增加466万元，增长372.24%；主要原因是：收到子公司往来资金款400万元所致；

(2) 合并后，收到其他与经营活动有关的现金增加437万元；

(3) 其他子公司合并影响减少402万元。

4.购买商品、接受劳务支付的现金：2014年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加8733万元，增长146.15%。主要原因是：

(1) 2014年1-9月母公司比上年同期增加1983万元，增长33.18%；主要原因是销售增长，采购总额增加，支付货款所致；

(2) 合并后，购买商品、接受劳务支付的现金增加6731万元。

5.支付给职工以及为职工支付的现金：2014年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加

1262万元，增长66%。主要原因是：

- (1) 2014年1-9月母公司比上年同期增加279万元，增长14.58%；
- (2) 合并后，支付给职工以及为职工支付的现金增加946万元；
- (3) 其他子公司合并影响增加37万元。

6.支付的各项税费：2014年1-9月支付的各项税费比上年同期增加1844万元，增长142%。主要原因是：

(1) 2014年1-9月母公司比上年同期减少422万元，下降33%；主要原因是：由于固定资产投资进项税金增加，利润减少导致应交所得税减少所致；

- (2) 合并后，支付的各项税费增加2266万元。

7.投资活动现金流入：2014年1-9月投资活动现金流入比上年同期减少4771.44万元，下降38.53%。主要原因是：

(1) 2014年1-9月母公司投资活动现金流入比上年同期减少1637万元，下降23%，主要原因是：1) 银行购买理财产品本金减少1499万元，下降23%；2) 理财投资收益减少32万元，下降52%；3) 收到子公司利润分配减少69万元；4) 定存利息收入减少41万元，下降8%；5) 处置固定资产收回的现金净额增加4万元；

(2) 合并江苏考普乐后，减少3149万元，主要原因是：1) 考普乐2014年1-9月增加1321万元；2) 2014年1-9月减少2013.9.30合并考普乐货币资金4470万元。

8. 投资活动现金流出：2014年1-9月投资活动现金流出比上年同期增加4620万元，增长29.98%。主要原因是：

(1) 2014年1-9月母公司投资活动现金流出比上年同期增加2905万元，增长22.41%。主要原因是：1) 购建固定资产比上年同期减少2309万元，下降58%；2) 对外投资比上年同期增加10313万元；3) 购银行理财产品比上年同期减少5099万元，下降57%；

- (2) 合并江苏考普乐后，投资活动现金流出比上年同期增加2470万元；

- (3) 其他子公司合并影响755万元。

9.吸收投资收到的现金：2014年1-9月吸收投资收到的现金比上年同期增加1923万元，上年同期为0。主要原因是：

- (1) 2014年1-9月母公司比上年同期增加1622万元，上年同期为0。为公司收到员工股权激励投资款；
- (2) 其他子公司合并影响301万元，为子公司吸收少数股东投资收到的现金。

10.取得借款收到的现金：2014年1-9月取得借款收到的现金比上年同期增加2000万元，上年同期为0。主要原因是：合并考普乐后，银行借款2000万元。

11.收到其他与筹资活动有关的现金：2014年1-9月收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少

1012万元，下降95%。主要原因是：2014年1-9月国家重大专项结束无政府拨款所致。

12.偿还债务支付的现金：2014年1-9月偿还债务支付的现金比上年同期增加2000万元，上年同期为0。主要原因是：合并江苏考普乐后，偿还债务支付的现金增加2000万元。

13.支付其他与筹资活动有关的现金：2014年1-9月支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少1979.20万元，下降96.41%。主要原因是：2014年1-9月国家重大专项项目结束，支出减少所致。

注：“重大变动”指变动幅度达到30%以上。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年前三季度，公司累计实现营业收入26144.29万元，比上年同期增长149.72%，归属于上市公司股东的净利润为4813.02万元，比上年同期增长119.61%。报告期内，公司合并全资子公司江苏考普乐新材料有限公司后业绩较上年同期实现了较大幅度的增长。合并前母公司净利润比上年同期下降36%，主要是由于报告期内，公司的新产品和新项目处于市场推广期，自主研发投入增加，同时募投项目建设完成，运行成本上升，致使经营业绩受到一定影响。

2014年前三季度，公司继续巩固在半导体领域的市场地位，不断挖掘潜力，寻求纵深发展。在传统封装领域，公司的晶圆划片刀产品已经获得了少量的销售订单；在晶圆制程市场开发方面，芯片铜互连电镀液产品在中芯国际（北京）进入中央供液系统，在中芯国际（上海）采购份额有所增加，在无锡海力士半导体（中国）有限公司产品已经通过验证，并且实现销售，同时铜制程清洗液也通过了中芯国际（上海）的生产线验证，并开始供货；在IC封装基板领域，公司的电镀铜添加剂产品已经获得客户验证通过并开始少量供货。

2014年上半年，上海新阳合作投资300mm半导体硅片项目，借此涉足半导体硅片产品，在半导体领域得到纵深发展。本项目致力于在我国建设300毫米半导体硅片生产基地，实现300毫米半导体硅片的国产化，同时发展200毫米抛光硅片生产能力，充分满足我国极大规模集成电路产业的对硅衬底基础材料的迫切要求。本项目产品能够填补国内空白，保证国内硅片供应的安全性及产业链的完整和稳定性。上海新阳将通过本投资项目进入高品质半导体硅片生产领域，进一步丰富公司产品结构，完善了公司发展战略布局，从而提升公司竞争力及经营业绩。

注：公司应分析说明驱动业务收入变化的具体因素，例如产销量、订单或劳务的结算比例等因素。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

注：公司应披露报告期重大的已签订单情况，以及前期订单在本报告期的进展和本报告期新增订单的完成比例。

数量分散的订单情况

适用  不适用

注：对前期订单分散且数量较多的，可以按客户所在行业口径归类披露。临时报告已经披露过的情况，公司可只提供相关披露索引。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

注：若报告期内产品或服务发生重大变化或调整，公司应介绍已推出或宣布将推出的新产品及服务，并说明可能对公司未来经营及业绩的影响。

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

注：公司应披露重要研发项目在本报告期的进展情况并预计对公司未来发展的影响。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

注：如果报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化，公司应加以说明并披露其对公司的影响，可能对公司产生严重不利影响的，还应披露公司拟采取的应对措施。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2014年前三季度前五大供应商	金额	上一年度前五大供应商	金额
前五大供应商采购金额合计	99,435,867.70	前五大供应商采购金额合计	41,842,943.00
占公司全部采购金额比例	47.16%	占公司全部采购金额比例	37.95%

2014年1-9月前五大供应商采购金额占公司全部采购金额比上年同期有所上升，主要原因是1-9月合并江苏考普乐。公司前五大供应商中有2家是上一年度前五大供应商，有2家是江苏考普乐公司供应商，另新增一家工程供应商。

公司前五大供应商的变化对公司未来的经营不会产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2014年前三季度前五大客户	金额	上一年度前五大客户	金额
前五大客户收入合计	50,447,675.20	前五大客户收入合计	32,875,221.46
占公司全部营业收入比例	19.30%	占公司全部营业收入比例	31.40%

2014年1-9月前五大客户销售金额占公司营业收入的比例有所下降；主要原因是2014年1-9月合并江苏考普乐后营业收入增加。公司前五大客户中有2家是上一年度前五大客户，有3家是江苏考普乐公司客户。

公司前五大客户的变化对公司未来的经营不会产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

本报告期，公司紧紧围绕着年初制定的经营计划开展工作，现就有关工作进展简述如下：

晶圆制程产品的市场开发、新产品推广和验证工作取得了一定进展，芯片铜互连电镀液产品在中芯国际（北京）进入中央供液系统，在中芯国际（上海）采购份额有所增加，在无锡海力士半导体（中国）有限公司产品已经通过验证，并且实现销售；芯片铜互连清洗液通过了中芯国际（上海）的生产线验证并已开始供货；除了面向国内半导体客户外，公司也投入力量在台湾、东南亚等地积极拓展市场。这些为公司未来在半导体高端制程材料市场中立足和发展打下了良好的基础。

公司组建了半导体划片项目团队，从事半导体划片化学品和划片刀配套应用，公司划片刀产品分别在长电科技、通富微电等几家中大型客户进行了部分型号的验证，验证结果良好，其中一种型号的产品已经取得通富微电的正式订单。如果后续使用情况能得到客户认可，将会逐步贡献业绩。由于划片刀属于高技术含量产品，存在技术风险，同时技术要求和型号繁杂，需要客户逐一验证，产品批量稳定生产也需要一个过程，放量进度尚存在不确定性。

公司还组建了基板项目团队，将公司电镀和清洗技术延伸到半导体IC基板领域，目前也已经进入了市场推广阶段，用于IC封装基板的电镀铜添加剂产品已经获得客户验证通过并开始少量供货。

2014年上半年，上海新阳合作投资300mm半导体硅片项目，从而进入高品质半导体硅片生产领域，进一步丰富公司产品结构，完善公司发展战略布局，提升公司竞争力及经营业绩。

2014年上半年，公司的三个募集资金投资项目全部建设完成，达到预定可使用状态。募投项目新产能的建成将为公司长远发展打下良好基础。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

### 1、新产品开发所面临的风险

公司的电子化学品具有品种多、批量少、升级快、研发投入大、周期长、风险高等特点，需要持续开发和 innovation。产品研发试制成功后，进行大规模生产时，任何设备工艺参数缺陷、员工素质差异等都可能导导致产品品质波动，面临产品难以规模化生产风险。

公司通过多年持续不断的研发投入，加强技术储备和科研管理，掌握了自主知识产权的核心技术，在电子化学品研发及生产领域积累了较为丰富的经验和技術储备，能够降低新产品开发的风险。

### 2、新产品市场推广风险

由于芯片制造工艺对环境、材料的严格要求，芯片制造企业一般选择认证合格的安全供应商保持长期合作，从而降低材料供应商变化可能导致的产品质量风险；同时，新的材料供应商必须通过芯片制造企业严格的公司和产品评估认证才能成为其合格供应商。因此，公司芯片铜互连电镀液及添加剂等新产品大规模市场销售市场推广面临客户的认证意愿、对公司质量管理能力的认可以及严格的产品认证等不确定因素，存在一定的市场推广风险。

公司一直高度重视新市场推广工作，并通过加大新产品市场开发投入、严格新产品质量管理、引进新

市场专业人员等手段控制新市场推广的风险。

### 3、行业和市场波动风险

半导体产业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点。公司主营业务处于半导体产业链的材料和设备支撑行业，其市场需求和全球及国内半导体产业的发展状况息息相关，因此，本公司的业务发展会受到半导体行业周期性波动的影响。如果全球及国内半导体行业再度进入发展低谷，则公司将面临业务发展放缓、业绩产生波动的风险。

未来几年公司将在技术开发和市场开发加大投入。开发市场、加速进口替代可以扩大公司市场份额，保证经营业绩；开发技术、持续推出新产品可以不断拓宽公司产品应用领域，提高产品毛利。

### 4、安全环保风险

公司从产品生产工艺看属精细化工行业，虽然公司细分产品多为配方类的电子化学品，生产过程的污染工艺较少，但在生产经营中仍存在着少量“三废”排放。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，以及主要客户对供应商产品品质和环境治理要求提高，环保治理成本将不断增加。同时，本公司生产过程中使用的部分原材料为酸碱和有机溶剂，如操作不当可能发生安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成一定的经济损失。

公司对安全和环保工作高度重视，通过了环境管理体系、职业健康与安全管理体系、安全标准化企业等多项认证，并获得了安全生产许可证、危险化学品经营许可证等资质，能够有效减少安全环保方面的风险。

### 5、核心技术泄密风险

公司拥有多项国家发明专利和实用新型专利，在不断研发的过程中，公司还形成了较多的非专利技术和核心配方，这些技术和配方都是公司技术领先的保证。如果出现任何侵犯本公司专利或相关知情人士违反保密义务的情形，可能对公司的正常经营产生不利影响。

公司自成立以来就非常注重对专利、非专利技术和核心配方的保护，为了保证公司的核心机密不外泄，公司与董事、监事、高级管理人员、所有研发人员以及管理、财务等各个岗位的核心人员均签订了《保密协议书》，采取了配方保密、专人保管等特殊方法，并通过岗位分离及权限设置，避免部分技术人员掌握全部核心技术内容，最大限度的降低核心技术泄密风险。

### 6、投资规模扩张和研发投入导致盈利能力下降的风险

随着募投项目逐步建成投产，公司投资规模迅速扩大，固定资产大幅增加将导致折旧成本大幅上升，同时公司近年来研发投入较大，如果公司市场开发工作进展不顺利，将会导致公司盈利能力下降的风险。

公司将全力做好新市场开发，不断挖掘和发现新的客户，力争减少盈利能力下降的风险。同时公司也集约运行，从管理上挖掘潜力，把运行成本的上升控制到最小程度。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司关于股权激励的承诺事项	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2011 年 11 月 07 日	2011 年 11 月 7 日至 2015 年 12 月 31 日	报告期内公司严格履行了上述承诺
	公司关于限制性股票股权激励的承诺事项	上海新阳承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 04 月 30 日	2014 年 4 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日	报告期内公司严格履行了上述承诺
资产重组时所作承诺	李昊、周海燕、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉	上海新阳本次向李昊、周海燕、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉等八名股东发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2013 年 04 月 25 日	2013 年 10 月 18 日至 2016 年 10 月 17 日	截至本报告出具日，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况
	程焱、罗瑞娥、胡美珍、王霞、苏州和信达及国发黎曼	上海新阳向程焱、罗瑞娥、胡美珍、王霞、苏州和信达及国发黎曼等六名股东发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。	2013 年 04 月 25 日	2013 年 10 月 18 日至 2014 年 10 月 17 日	截至本报告出具日，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况
	李昊等考普乐 14 名股东	考普乐 2013 年、2014 年、2015 年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 3,620 万元、4,055 万元、4,580 万元。如考普乐在承诺期内未能实现承诺净利润，则交易对方需向上市公司进行补偿。	2013 年 04 月 25 日	2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	考普乐 2013 年实现的合并报表扣非后净利润为 3797.56 万元，完成了 2013 年业绩承诺。截至本报告出具日，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。
	李昊	如罗瑞娥等五名现金补偿义务人及程焱不能履行《发行股份购买资产盈利补偿协议》约定的现金补偿义务，则本人承担连带责任，向上海新阳半导体材料股份有限公司承担相应的现金补偿义务。	2013 年 04 月 25 日	2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	截至本报告出具日，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况



	李昊、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉	为保证标的公司持续稳定地开展生产经营，李昊、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉等七名管理层股东承诺自资产交割日起，仍需至少在标的公司任职 60 个月，并与标的公司签订期限为 60 个月的《劳动合同》，且在标的公司不违反相关劳动法律法规的前提下，不得单方解除与标的公司的劳动合同。如任何一名管理层股东违反任职期限承诺，则该违约方应向上海新阳进行补偿。	2013 年 04 月 25 日	2013 年 9 月 26 日至 2018 年 9 月 25 日	截至本报告出具日，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况
	李昊、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉	本次交易完成后，本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与上海新阳及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与上海新阳及其下属公司经营的业务构成或可能构成竞争的其他企业；如本人及本人控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与上海新阳及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入上海新阳的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与上海新阳主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。	2013 年 04 月 25 日	长期	截至本报告出具日，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况
	李昊、周海燕、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉、程焱	本人在股份限售期内不转让所持股份，对取得的上海新阳股份不设置质押等权利受限的其他行为，不从事不能清偿到期债务从而导致本人所持股份被冻结和强制执行的民事行为等，以保证本人切实履行与上海新阳之间《发行股份购买资产盈利预测补偿协议》中的股份补偿义务。	2013 年 04 月 25 日	2013 年 10 月 18 日至 2016 年 10 月 17 日	截至本报告出具日，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	三名法人股东关于股份锁定的承诺	自上海新阳半导体材料股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在本次发行前本公司已持有的上海新阳半导体材料股份有限公司股份，也不由上海新阳半导体材料股份有限公司回购在本次发行前本公司已持有的上海新阳半导体材料股份有限公司股份。	2011 年 06 月 16 日	2011 年 6 月 29 日至 2014 年 6 月 28 日	各承诺人均严格履行了上述承诺，该承诺现已履行完毕。
	董事、监事、高级管理人员王福祥、孙江燕、陈佩卿、贺岩峰、吕海波、	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其在本次发行前已直接或间接持有的公司股	2011 年 06 月 16 日	2011 年 6 月 29 日至 2014 年 6 月 28 日	报告期内各承诺人均严格履行了上述承诺。

	智文艳、王振荣、徐玉明关于股份锁定的承诺	份。在上述承诺期满后，在其或其关联自然人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的百分之二十五；在其或其关联自然人离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。			
	本公司间接股东王福祥、孙江燕、陈佩卿、贺岩峰、吕海波、智文艳、王振荣、陈慧、张驰、陈宏霞、徐玉明关于股份锁定的承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的新加坡新阳/新晖管理/新科投资的股权，也不由新加坡新阳/新晖管理/新科投资回购本人持有的股权；同时，承诺在上述期间，所持新加坡新阳/新晖管理/新科投资的股权比例不发生变动。	2011年06月16日	2011年6月29日至2014年6月28日	各承诺人均严格履行了上述承诺，该承诺现已履行完毕。
	本公司间接股东王溯（系实际控制人、董事王福祥和孙江燕之子）关于股份锁定的承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托王福祥以外的其他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本次发行前其直接或间接持有的公司股份。上述承诺期满后，在其或其关联自然人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的百分之二十五；在其或其关联自然人离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份。自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托王福祥以外的其他人管理其持有的新晖管理的股权，也不由新晖管理回购其持有的股权；同时，承诺在上述期间，所持新晖管理的股权比例不发生变动。	2011年06月16日	2011年6月29日至2014年6月28日	报告期内承诺人严格履行了上述承诺。
	实际控制人王福祥、孙江燕夫妇的其他承诺	如股份公司及上海新阳电子化学有限公司因股份公司首次公开发行股票并在创业板上市前违反国家和地方外资管理、税收、社会保险及住房公积金等相关法律法规而被处罚的情形，则相关费用由本人全额承担。	2010年07月30日	长期	报告期内承诺人严格履行了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	三名法人股东关于避免同业竞争的承诺	本公司目前未从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似的业务，也未投资与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似业务的其他企业，不存在与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司直接或间接从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司具有同业竞争或潜在同业竞争的业务；如从第三方获得的任何与	2010年07月30日	长期	报告期内承诺人严格履行了上述承诺。

		上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争商业机会, 则立即通知上海新阳半导体材料股份有限公司, 并尽力将该商业机会让予上海新阳半导体材料股份有限公司。			
	实际控制人王福祥、孙江燕夫妇关于避免同业竞争的承诺	本人及本人直系亲属目前未从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似的业务, 也未投资与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似业务的其他企业, 不存在与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司直接或间接同业竞争的情况。本人及本人直系亲属将来也不直接或间接从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司具有同业竞争或潜在同业竞争的业务; 如从第三方获得的任何与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争商业机会, 则立即通知上海新阳半导体材料股份有限公司, 并尽力将该商业机会让予上海新阳半导体材料股份有限公司。	2010 年 07 月 30 日	长期	报告期内承诺人严格履行了上述承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用。				

注: 承诺方李昊等 14 名原考普乐股东目前只有李昊持有本公司 5% 以上股份, 其余 13 名股东持有本公司股份未达 5%。

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额	21,452.52		
报告期内变更用途的募集资金总额	说明: 公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点	本季度投入募集资金总额	9,265.79
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	22,418.88
累计变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
半导体封装化学材料技术改造项目	否	11,201.03	11,201.03	222.65	8,754.84	78.16%	2014年06月30日	0	0	否	否
半导体封装表面处理设备技术改造项目	否	3,311.39	3,311.39	35.63	2,840.85	85.79%	2014年06月30日	0	0	否	否
技术中心改造项目	否	2,987.57	2,987.57	9.59	722.41	24.18%	2014年06月30日	0	0	否	否
300mm 半导体硅片项目	是			5,793.44	5,793.44						
承诺投资项目小计	--	17,499.99	17,499.99	6,061.31	18,111.54	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
300mm 半导体硅片项目				3,204.48	3,204.48						
新阳海斯注册资本					312.86						
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--				790		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			3,204.48	4,307.34	--	--	0	0	--	--
合计	--	17,499.99	17,499.99	9,265.79	22,418.88	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、“半导体封装化学材料技术改造项目”和“半导体封装表面处理设备技术改造项目”由于新建产能刚开始运行，相关营业收入没有明显上升，经济效益尚未显现。 2、“技术中心技术改造项目”由于本项目产出为科研成果，不产生直接的经济效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、经公司 2012 年 8 月 15 日召开的第一届董事会第二十一次会议决议，同意将超募资金中的人民币 790.00 万元永久补充公司流动资金。										

	<p>2、经公司 2014 年 2 月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议决议，同意使用部分超募资金 312.86 万人民币（51 万美元）作为注册资本投入公司的控股子公司上海新阳海斯高科技材料有限公司。</p> <p>3、经公司 2014 年 8 月 13 日召开的第二届董事会第十五次会议和 2014 年 9 月 2 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议，同意将公司节余超募资金及利息收入 3204.48 万元作为注册资金投入上海新昇半导体科技有限公司。截至 2014 年 9 月 30 日止，超募资金已全部使用完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于 2011 年 8 月 17 日经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具会审字（2011）第 4477 号鉴证报告核准，以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金 1,332.05 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、“半导体封装化学材料技术改造项目”募集资金专户节余资金 2,705.98 万元。节余原因如下：（1）由于本项目与公司承担的国家 02 科技重大专项“65-45nm 芯片铜互连超高纯电镀液及添加剂研发和产业化”项目的部分建设内容重合，部分投资使用国家专项拨款，本项目同时获得国家技改项目扶持资金，在一定程度上节约了项目投入；（2）项目执行过程中，公司充分发挥自身技术优势，利用自身生产工艺方面积累的丰富经验，通过招标等手段严控成本，也一定程度节约了项目投入。</p> <p>2、“半导体封装表面处理设备技术改造项目”募集资金专户节余资金 603.62 万元。节余原因如下：由于近年来国内外经济形势发生了复杂的变化，半导体行业的持续低迷对专用设备市场产生了一定不利影响，公司因此适当调整了对表面处理设备技改项目的投入，同时，公司通过充分发挥自身技术优势，利用自身生产工艺方面积累的丰富经验，严控成本，节约投入，一定程度节约了项目投入。</p> <p>3、“技术中心技术改造项目”募集资金专户节余资金 2,438.03 万元。节余原因如下：（1）由于本项目与公司承担的国家 02 科技重大专项“65-45nm 芯片铜互连超高纯电镀液及添加剂研发和产业化”项目的部分建设内容重合，部分投资使用国家专项拨款，在一定程度上节约了项目投入；（2）项目执行过程中，公司根据研发项目的实际需要，调整了研发方式和部分研发设备的购置计划，也一定程度节约了项目投入。</p> <p>4、经公司 2014 年 8 月 13 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，截止 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目“半导体封装化学材料技术改造项目”、“半导体封装表面处理设备技术改造项目”、“技术中心技术改造项目”已经达到预定可使用状态，予以结项。结项后，上述三个项目除应付未付金额之外，不再投入募集资金。截止 2014 年 6 月 30 日，以上三个项目合计结余募集资金（含利息净收入）5,747.63 万元。</p> <p>5、经公司 2014 年 9 月 2 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议，公司于 2014 年 9 月 3 日将上述结余募集资金（含截至投入当日的利息净收入）合计 5793.44 万元作为注册资金投入上海新昇半导体科技有限公司，用于 300 毫米半导体硅片项目的建设。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2014 年 9 月 30 日，公司在浦发银行松江支行、上海银行松江支行的募集资金专项账户内尚有资金余额 528 万元，用以支付因工程和设备质保金形成的应付未付金额。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

注：请各上市公司按照我部于 2014 年 9 月 12 日发布的《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》的要求，分析准则涉及的相关会计政策变动对自身财务状况及经营成果的影响，以及具有重要影响的准则变动对公司合并财务报表的影响，并在 2014 年三季度报告中，按上述《通知》的格式和内容要求予以披露。

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

1、公司于 2014 年 4 月 18 日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议并通过了《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。

2、2014 年 6 月 3 日，中国证监会对公司报送的首期限限制性股票激励计划（草案）确认无异议并进行了备案。

3、2014 年 6 月 16 日，公司召开 2013 年度股东大会审议并通过了《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于 2014 年 7 月 4 日分别召开第二届董事会第十四次、第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于调整首期限限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

5、截止本报告公告日，限制性股票的授予登记已经完成。2014 年 10 月 9 日，公司在中国证监会指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于限制性股票授予登记完成的公告》。

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

#### 1、利润分配政策的实施情况

公司严格执行了《公司章程》中对于现金分红政策和利润分配政策的相关规定，积极回报股东，在保证公司长期、持续、健康发展对现金需求的前提下进行了较高比例的现金分红。独立董事和监事会充分履行了职责，对利润分配预案均发表了专项意见，经董事会、股东大会审议通过之后在规定时间内实施完毕。利润分配方案的决策程序和决策机制符合《公司章程》等相关法律法规的规定，切实保障了全体股东的权益。

2014 年 6 月 16 日，公司召开了 2013 年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配方案》：以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 113,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元(含税)，该方案已于 7 月 4 日执行完毕。

## 2、利润分配政策的调整情况

报告期内，公司根据中国证监会的最新规定对公司的利润分配政策进行了补充和修订，并在2014年9月5日将《公司章程》全文刊登在中国证监会指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

综上，公司现金分红政策的制定及执行情况符合《公司章程》对利润分配政策的规定，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事充分履行职责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到了充分保障。

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

公司 2014 年度合并后的净利润与上年同期相比预计会有较大幅度增长，增长幅度大约在 40-60%，主要为 2014 年度合并全资子公司江苏考普乐新材料有限公司所致。

2014 年度合并前的母公司净利润与上年同期相比预计会有较大幅度下降，下降幅度大约在 30-50%，主要是由于公司的新产品和新项目处于市场推广期，自主研发投入增加，同时募投项目建设完成，运行成本上升，致使经营业绩受到一定影响。

## 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	117,643,771.76	218,295,122.88
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	55,281,372.26	71,071,323.53
应收账款	225,471,754.97	201,413,367.85
预付款项	5,877,993.78	2,369,874.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,469,295.68
应收股利		
其他应收款	1,896,671.95	2,306,093.89
买入返售金融资产		
存货	71,465,138.73	46,441,112.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172.62	680,125.15
流动资产合计	477,636,876.07	544,046,316.17
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		15,000,000.00



长期应收款		
长期股权投资	100,650,000.00	650,000.00
投资性房地产		
固定资产	153,222,661.10	51,579,476.46
在建工程	46,694,811.69	118,864,813.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,442,995.39	78,654,876.19
开发支出	3,285,546.46	4,117,146.46
商誉	133,878,847.88	133,878,847.88
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,203,348.16	5,203,348.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	520,378,210.68	407,948,508.16
资产总计	998,015,086.75	951,994,824.33
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	51,141,993.14	47,802,728.80
应付账款	46,664,304.92	44,542,175.89
预收款项	2,536,011.60	6,440,297.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	898,699.00	3,106,899.36
应交税费	8,458,082.78	9,640,690.60
应付利息	28,000.00	23,333.33
应付股利		
其他应付款	3,615,503.50	4,683,926.38

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	133,342,594.94	136,240,051.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,882,786.35	20,287,681.31
非流动负债合计	19,882,786.35	20,287,681.31
负债合计	153,225,381.29	156,527,732.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	114,912,000.00	113,800,000.00
资本公积	583,024,714.05	566,404,333.05
减：库存股		
专项储备	5,887,207.72	4,630,103.98
其他综合收益		
盈余公积	16,822,476.83	16,822,476.83
一般风险准备		
未分配利润	121,456,384.23	93,810,177.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	842,102,782.83	795,467,091.50
少数股东权益	2,686,922.63	
所有者权益（或股东权益）合计	844,789,705.46	795,467,091.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	998,015,086.75	951,994,824.33

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	67,980,314.90	170,177,442.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	18,055,631.04	20,289,280.99
应收账款	70,678,370.34	58,772,420.76
预付款项	4,976,707.03	1,875,217.46
应收利息		1,263,435.56
应收股利		
其他应收款	1,365,460.77	1,937,151.23
存货	24,354,704.28	18,037,369.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		599,793.16
流动资产合计	187,411,188.36	272,952,110.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		11,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	497,625,671.52	394,497,025.52
投资性房地产		
固定资产	137,745,498.55	35,619,717.99
在建工程	8,973,934.27	95,819,025.27
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,673,289.50	9,890,939.20
开发支出	3,285,546.46	4,117,146.46
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,239,390.22	1,239,390.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	658,543,330.52	552,183,244.66
资产总计	845,954,518.88	825,135,355.46
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		520,630.00
应付账款	19,370,278.14	14,843,889.06
预收款项	2,017,180.60	2,081,631.00
应付职工薪酬		2,522,799.36
应交税费	4,180,106.16	1,083,244.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,471,727.35	978,101.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	30,039,292.25	22,030,294.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,882,786.35	20,287,681.31
非流动负债合计	19,882,786.35	20,287,681.31
负债合计	49,922,078.60	42,317,976.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	114,912,000.00	113,800,000.00
资本公积	582,898,017.55	566,277,636.55

减：库存股		
专项储备	6,047,479.24	4,479,174.61
其他综合收益		
盈余公积	16,822,476.83	16,822,476.83
一般风险准备		
未分配利润	75,352,466.66	81,438,091.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	796,032,440.28	782,817,379.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	845,954,518.88	825,135,355.46

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	107,583,773.07	33,466,638.16
其中：营业收入	107,583,773.07	33,466,638.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,260,707.13	33,781,993.58
其中：营业成本	64,744,437.41	16,632,042.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	545,684.11	272.00
销售费用	6,674,581.83	1,930,023.11
管理费用	13,476,903.11	16,116,774.50
财务费用	-553,850.32	-1,149,834.14

资产减值损失	2,372,950.99	252,715.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	30,601.64	317,688.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,353,667.58	2,332.87
加：营业外收入	719,601.22	5,621,096.30
减：营业外支出	-22,265.13	
其中：非流动资产处置损失	-30,072.00	22,591.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,095,533.93	5,623,429.17
减：所得税费用	3,831,269.49	778,743.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,264,264.44	4,844,685.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	17,503,314.56	4,844,685.68
少数股东损益	-239,050.12	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.06
（二）稀释每股收益	0.15	0.06
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	17,264,264.44	4,844,685.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,503,314.56	4,844,685.68
归属于少数股东的综合收益总额	-239,050.12	

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	43,273,689.07	33,466,638.16
减：营业成本	26,585,250.88	16,647,128.41
营业税金及附加	162,970.10	272.00
销售费用	2,275,123.62	1,930,023.11
管理费用	8,696,198.53	16,085,052.88
财务费用	-794,304.47	-1,150,047.94
资产减值损失	525,161.10	252,715.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		301,052.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,823,289.31	2,546.89
加：营业外收入	519,601.22	5,621,096.30
减：营业外支出	-30,072.00	
其中：非流动资产处置损失	-30,072.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,372,962.53	5,623,643.19
减：所得税费用	1,395,426.06	763,604.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,977,536.47	4,860,038.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		

七、综合收益总额	4,977,536.47	4,860,038.55
----------	--------------	--------------

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	261,442,894.90	104,696,067.50
其中：营业收入	261,442,894.90	104,696,067.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,676,128.60	94,361,679.28
其中：营业成本	153,368,190.30	50,816,023.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,283,780.01	207,987.90
销售费用	15,522,207.52	5,379,785.79
管理费用	37,490,273.83	42,672,867.36
财务费用	-2,495,651.27	-5,289,465.28
资产减值损失	507,328.21	574,479.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	446,479.29	664,141.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,213,245.59	10,998,529.22



加：营业外收入	1,146,687.96	14,939,457.62
减：营业外支出	89,583.44	162,591.39
其中：非流动资产处置损失	25,776.57	22,591.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,270,350.11	25,775,395.45
减：所得税费用	9,458,243.89	3,859,188.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,812,106.22	21,916,206.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	48,130,206.59	21,916,206.47
少数股东损益	-318,100.37	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.42	0.26
（二）稀释每股收益	0.42	0.26
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	47,812,106.22	21,916,206.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,130,206.59	21,916,206.47
归属于少数股东的综合收益总额	-318,100.37	

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	112,843,818.65	104,696,067.50
减：营业成本	67,397,052.29	50,861,281.07
营业税金及附加	395,822.03	207,987.90

销售费用	5,906,895.57	5,379,785.79
管理费用	25,384,091.26	42,609,166.27
财务费用	-3,119,294.23	-5,220,813.92
资产减值损失	1,053,158.41	599,279.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	295,260.30	1,302,678.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,121,353.62	11,562,059.14
加：营业外收入	879,687.96	14,939,457.62
减：营业外支出	61,776.57	141,200.00
其中：非流动资产处置损失	25,776.57	1,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,939,265.01	26,360,316.76
减：所得税费用	2,540,889.75	3,844,050.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,398,375.26	22,516,266.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	14,398,375.26	22,516,266.63

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	225,248,537.93	117,859,164.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	43,592.88	14,381.86
收到其他与经营活动有关的现金	6,289,235.93	1,281,078.12
经营活动现金流入小计	231,581,366.74	119,154,624.02
购买商品、接受劳务支付的现金	147,074,770.42	59,749,759.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,795,604.12	19,171,934.47
支付的各项税费	31,436,729.14	12,987,366.90
支付其他与经营活动有关的现金	14,511,363.22	12,366,365.59
经营活动现金流出小计	224,818,466.90	104,275,426.62
经营活动产生的现金流量净额	6,762,899.84	14,879,197.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,700,000.00	
取得投资收益所收到的现金	446,479.29	664,141.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	4,922,310.01	123,158,870.39
投资活动现金流入小计	76,108,589.30	123,823,011.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,016,281.87	37,706,350.97
投资支付的现金	155,700,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		104,409,597.36
投资活动现金流出小计	184,716,281.87	142,115,948.33
投资活动产生的现金流量净额	-108,607,692.57	-18,292,936.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,229,103.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,005,023.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	532,120.00	10,649,419.01
筹资活动现金流入小计	39,761,223.00	10,649,419.01
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,221,333.33	17,036,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	736,813.27	20,528,825.29
筹资活动现金流出小计	41,958,146.60	37,564,825.29
筹资活动产生的现金流量净额	-2,196,923.60	-26,915,406.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	609.07	-70,490.63
五、现金及现金等价物净增加额	-104,041,107.26	-30,399,636.45
加：期初现金及现金等价物余额	196,113,284.06	237,902,006.43
六、期末现金及现金等价物余额	92,072,176.80	207,502,369.98

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	120,747,594.70	117,859,164.04
收到的税费返还	37,972.88	10,206.63
收到其他与经营活动有关的现金	5,917,529.60	1,253,078.12
经营活动现金流入小计	126,703,097.18	119,122,448.79
购买商品、接受劳务支付的现金	79,576,031.41	59,749,759.66
支付给职工以及为职工支付的现金	21,898,832.05	19,111,656.63
支付的各项税费	8,765,606.02	12,987,194.28
支付其他与经营活动有关的现金	9,814,971.34	12,362,556.26
经营活动现金流出小计	120,055,440.82	104,211,166.83
经营活动产生的现金流量净额	6,647,656.36	14,911,281.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	295,260.30	1,302,678.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,482,987.89	69,888,314.08
投资活动现金流入小计	54,818,048.19	71,190,992.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,537,350.02	37,706,350.97
投资支付的现金	142,128,646.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		91,909,597.36
投资活动现金流出小计	158,665,996.02	129,615,948.33
投资活动产生的现金流量净额	-103,847,947.83	-58,424,955.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,224,080.00	

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	532,120.00	10,649,419.01
筹资活动现金流入小计	16,756,200.00	10,649,419.01
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,484,000.00	17,036,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	736,813.27	20,528,825.29
筹资活动现金流出小计	21,220,813.27	37,564,825.29
筹资活动产生的现金流量净额	-4,464,613.27	-26,915,406.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	480.07	-70,171.61
五、现金及现金等价物净增加额	-101,664,424.67	-70,499,251.64
加：期初现金及现金等价物余额	169,644,141.18	233,216,537.84
六、期末现金及现金等价物余额	67,979,716.51	162,717,286.20

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

上海新阳半导体材料股份有限公司

2014 年 10 月 23 日